



Tiratura | **Print-run** 7.756  
 Certificato CSST n. 2009-1966  
 Diffusione | **Circulation** 7.513  
 Qualità della diffusione certificata da BVQI (Bureau Veritas Italia)  
**BVQI CERTIFICATO N.409/001** rilasciato in data 17/03/2009  
 Mensile 9 numeri (numero unico: Gennaio/Febbraio Luglio/Agosto Novembre/Dicembre)  
 Monthly 9 issues (January/February July/August November/December: combined issue)  
 Data pubblicazione | **Issue date** 1<sup>a</sup> settimana del mese  
*First week of each month*  
 Tipo di stampa | **Printing process** Offset piana / Web offset

- **ELETRONICA OGGI** offre una visione a 360° del mondo delle tecnologie elettroniche. La rivista fornisce a ingegneri, manager tecnici e progettisti informazioni tempestive e approfondite che interessano tutti i settori dell'elettronica professionale – microprocessori, IC analogici e digitali, logiche programmabili, potenza, interconnessioni e packaging, la strumentazione di misura & collaudo e il software di progettazione. Certificata CSST, **ELETRONICA OGGI** è distribuita in abbonamento e con mailing list e garantisce, unica rivista in Italia, la qualità della diffusione mediante certificazione BVQI.
- **EO-WEB** ([www.eo-web.it](http://www.eo-web.it)), l'edizione online di **ELETRONICA OGGI**, è il complemento indispensabile dell'edizione cartacea. News di prodotto, white paper, note applicative, idee di progetto, interviste esclusive sulle evoluzioni delle più recenti tecnologie rappresentano una risorsa informativa preziosa in ogni fase del ciclo di design, dall'idea alla produzione.

Rivista Ufficiale di  
 Official Magazine of



Distretto dell'Elettronica  
 e delle Tecnologie Avanzate

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita  
*Space booking: 45 days before publication date*

Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita  
*Delivery material: 35 days before publication date*

## LISTINO / LISTINO

Formati	Formats	Euro 4/c
1/4 PAGINA	1/4 PAGE	900
1/3 PAGINA	1/3 PAGE	1.100
1/2 PAGINA	1/2 PAGE	2.000
2/3 PAGINA	2/3 PAGE	2.300
PAGINA	PAGE	2.800
MASTER	MASTER	9.000
I ROMANA	THIRD PAGE	3.300
COPERTINA	COVER	11.000
II COPERTINA	INSIDE FRONT COVER	3.500
III COPERTINA	INSIDE BACK COVER	2.900
IV COPERTINA	BACK COVER	5.100
BATTENTE COP.	COVER LEAF	6.600
INSERTO 2 FACCIATE	INSERT 2 FRONT	3.000
INSERTO 4 FACCIATE	INSERT 4 FRONT	5.000

- **ELETRONICA OGGI** offers a global view of the electronic technologies world. The magazine provides engineers, technical managers and designers with well-timed and deep information concerning all professional electronic areas – microprocessor, analogic and digital ICs, programmable logic devices, power, interconnections and packaging, T&M instrumentation and design software. **ELETRONICA OGGI** is the first and unique italian magazine CSST certified. The magazine is distributed upon subscription and BVQI certified mailing list.
- **EO-WEB** ([www.eo-web.it](http://www.eo-web.it)), the **ELETRONICA OGGI** online edition, is the indispensable complement of the paper edition. Product news, white papers, application notes, design ideas, exclusive interviews concerning most recent technologies evolution are a precious source in every design cycle step, from idea to manufacturing.

### Settori di interesse Fields of interest



### Funzione aziendale Job function

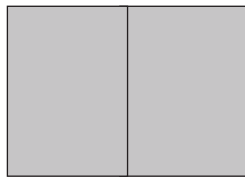


NUMERO ISSUE	SPECIALE (COVER STORY)	APPROFONDIMENTI UPDATE/IN DEPTH	ARTICOLI GENERALI GENERAL ISSUES	FIERE EXHIBITIONS
<b>406</b> Gennaio/Febbraio <i>January/February</i>	▶ Batterie e fuel-cell ( <i>Batteries and fuel cells</i> )	▶ Tool progettazione on line ( <i>On line design tools</i> ) ▶ IC controllo movimento ( <i>Motion control ICs</i> )	▶ IC analogici/mixed signal ( <i>Analog/Mixed signal ICs</i> ) ▶ Innovazione nei display ( <i>Innovation in displays</i> ) ▶ Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M Instruments</i> ) ▶ Nanomateriali ( <i>Nanomaterials</i> ) ▶ Logiche programmabili ( <i>PLDs</i> )	<b>Opti 2011</b> 28-30/01 - Monaco (D) <b>NI Days</b> febbraio - Milano (I)
<b>407</b> Marzo <i>March</i>	▶ IC di conversione ( <i>Conversion ICs</i> )	▶ Nuove tecnologie di memoria ( <i>New technologies for memory</i> ) ▶ Nuove architetture di microprocessore ( <i>New architectures for microprocessor</i> )	▶ Potenza digitale ( <i>Digital power</i> ) ▶ Test analogico ( <i>Analog test</i> ) ▶ Elettromeccanici/passivi/connettori ( <i>Passive/electromechanics/connectors</i> ) ▶ Elettronica consumer ( <i>Consumer electronics</i> ) ▶ Optoelettronica ( <i>Optoelectronics</i> )	<b>Embedded World 2011</b> , 01-03/03 - Norimberga (D) <b>CeBIT 2011</b> , 01-05/03 - Hannover (D) <b>Date 2011</b> , 14-18/03 - Grenoble (F) <b>EMV 2011</b> , 15-17/03 - Stoccarda (D) <b>Smart Systems Integration 2011</b> 02-23/03 - Dresden (D) <b>MC<sup>+</sup> - Motion Control for</b> , marzo - Bologna (I)
<b>408</b> Aprile <i>April</i>	▶ Strumentazione per test wireless ( <i>Wireless test instruments</i> )	▶ IC di alimentazione ( <i>Power supply ICs</i> ) ▶ Cloud computing	▶ RF/wireless ▶ IC analogici/mixed signal ( <i>Analog/mixed signal ICs</i> ) ▶ Green engineering ▶ Riutilizzo del design ( <i>Design reuse</i> ) ▶ Elettronica di potenza ( <i>Power electronics</i> )	<b>Hannover Messe 2011</b> 04-08/04 - Hannover (D) <b>Display International 2011</b> 13-15/04 - Tokyo (J)
<b>409</b> Maggio <i>May</i>	▶ Soluzioni programmabili ( <i>Programmable solutions</i> )	▶ Illuminazione a stato solido ( <i>Solid state lighting</i> ) ▶ Smart grid	▶ ASIC/ASSP ▶ Integrità dei segnali ( <i>Signal integrity</i> ) ▶ Nanotecnologie ( <i>Nanotechnologies</i> ) ▶ Analizzatori di segnali ( <i>Signal analyzers</i> ) ▶ Standard wireless ( <i>Wireless standards</i> ) ▶ Optoelettronica e fotonica ( <i>Optoelectronics &amp; photonics</i> )	<b>Embedded Systems Conference Silicon Valley</b> 02-05/05 - San José (CA-USA) <b>SMT/Hybrid/Packaging 2011</b> 03-05/05 - Norimberga (D) <b>PCIM Europe 2011</b> 17-19/05 - Norimberga (D) <b>Laser World of Photonics</b> 23-26/05 - Monaco (D) <b>SPS Italia</b> , 24-26/05 - Parma (I)
<b>410</b> Giugno <i>June</i>	▶ DSP Directory ( <i>Directory DSP</i> )	▶ Convertitori c.c./c.c. ( <i>d.c./d.c converters</i> ) ▶ Elettronica & auto elettrica ( <i>Electronics and electric cars</i> )	▶ Interconnessioni seriali ( <i>Serial interconnections</i> ) ▶ Energie alternative ( <i>Alternative energies</i> ) ▶ Software per la progettazione con FPGA ( <i>FPGA development software</i> ) ▶ Elettronica 3D ( <i>3D electronics</i> ) ▶ MEMS e sensori avanzati ( <i>MEMS and advanced sensors</i> )	<b>VforM - Vision for Manufacturing</b> giugno (I)
<b>411</b> Luglio/Agosto <i>July/August</i>	▶ Nuove tecnologie ( <i>New technologies</i> )	▶ Standard wireless ( <i>Wireless standards</i> ) ▶ Processori grafici ( <i>GPUs</i> )	▶ Processori video (Video processors) ▶ Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instrumentation</i> ) ▶ Reverse engineering ( <i>Reverse engineering</i> ) ▶ IC di gestione della potenza ( <i>Power managements ICs</i> ) ▶ PoE ( <i>Power over Ethernet</i> )	<b>Ni-Week 2011</b> agosto - Austin (Texas-USA)
<b>412</b> Settembre <i>September</i>	▶ Strumentazione palmare/portatile ( <i>Portable instruments</i> )	▶ Touchscreen ICs ▶ Tecniche e algoritmi di cifratura ( <i>Cypher methodologies and algorithms</i> )	▶ Elettromeccanici/passivi/connettori ( <i>Electromechanics/ passives/connectors</i> ) ▶ IC di conversione ( <i>Conversion ICs</i> ) ▶ Logiche programmabili ( <i>PLDs</i> ) ▶ Conservazione dell'energia ( <i>Energy harvesting</i> ) ▶ Chip grafici ( <i>Graphic chips</i> )	<b>Control &amp; Communication</b> settembre (I)
<b>413</b> Ottobre <i>October</i>	▶ Optoelettronica ( <i>Optoelectronics</i> )	▶ IP/SoCs ▶ Internet of things	▶ Sicurezza dei dati ( <i>Data security</i> ) ▶ IC analogici/Mixed signal ( <i>Analog/Mixed signal ICs</i> ) ▶ Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instrumentation</i> ) ▶ MCU low-power ( <i>Low power MCUs</i> ) ▶ Energie alternative/rinnovabili ( <i>Renewable/alternative energies</i> )	<b>Same 2011</b> ottobre - Grenoble (F)
<b>414</b> Novembre/Dicembre <i>November/December</i>	▶ DSP	▶ Nuove batterie ( <i>New batteries</i> ) ▶ Sensori avanzati ( <i>Advanced sensors</i> )	▶ Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instruments</i> ) ▶ IC analogici/mixed signal ( <i>Analog/mixed signal ICs</i> ) ▶ Semiconduttori per data center ( <i>Semiconductor for data centers</i> ) ▶ Standard wireless ( <i>Wireless standards</i> ) ▶ Nanotecnologie ( <i>Nanotechnologies</i> )	<b>IP 2011</b> , dicembre - Grenoble (F) <b>Productronica 2011</b> , 15-18/11 - Monaco (D) <b>SPS/IPC/Drives 2011</b> 22-24/11 - Norimberga (D) <b>Focus Embedded</b> , novembre (I) <b>E-Tech</b> , 16-19/11 - Milano (I)

AUTOMAZIONE OGGI • FIELDBUS & NETWORKS • ELETTRONICA OGGI • EMBEDDED •  
 RMO - Rivista di Meccanica Oggi • SdA - Soluzioni di Assemblaggio • PROGETTARE • FLUIDOTECNICA



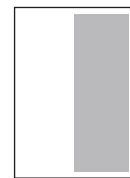
**PAGINA INTERA**  
 FULL PAGE  
 210 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 190 X 260 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



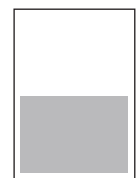
**DOPPIA PAGINA UNI**  
 DOUBLE PAGE  
 SPREAD UNI  
 420 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED



**2/3 PAG. VERTICALE**  
 IN GABBIA  
 2/3 PAGE VERTICAL  
 (TYPE AREA)  
 118 X 260 mm



**1/2 PAG. VERTICALE**  
 HALF PAGE VERTICAL  
 100 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 90 X 260 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



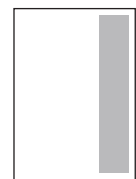
**1/2 PAG. ORIZZONTALE**  
 HALF PAGE HORIZONTAL  
 210 X 140 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 190 X 130 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



**1/4 PAG. ORIZZONTALE**  
 1/4 PAGE HORIZONTAL  
 100 X 130 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 90 X 120 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



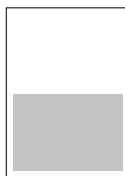
**1/3 PAG. ORIZZONTALE**  
 1/3 PAGE HORIZONTAL  
 210 X 105 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 181 X 90 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



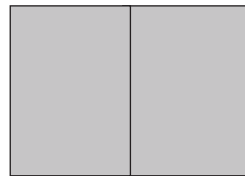
**1/3 PAG. VERTICALE**  
 1/3 PAGE VERTICAL  
 80 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED  
 56 X 260 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA

## AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

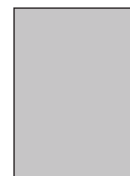
- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm  
 SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm  
 BLEED



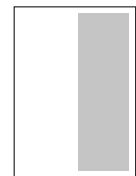
**1/2 PAG. ORIZZONTALE**  
 HALF PAGE HORIZONTAL  
 180 X 125 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA



**DOPPIA PAGINA UNI**  
 DOUBLE PAGE SPREAD UNI  
 420 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED

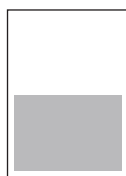


**PAGINA INTERA**  
 FULL PAGE  
 210 X 297 mm  
 (VIVO + REFIL) / BLEED



**1/2 PAG. VERTICALE**  
 HALF PAGE VERTICAL  
 90 X 240 mm  
 (IN GABBIA) / TYPE AREA

## EO NEWS



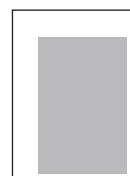
**1/2 PAGINA ORIZZONTALE**  
 1/2 PAGE HORIZONTAL  
 265 X 154 mm  
 + REFIL / BLEED  
 235 X 137 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA



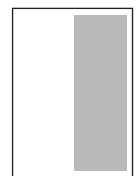
**DOPPIA KING SIZE**  
 DOUBLE KING SIZE PAGE  
 530 X 310 mm + REFIL / BLEED  
 500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE  
 AREA



**KING SIZE / KING SIZE**  
 265 X 310 mm  
 + REFIL / BLEED  
 245 X 290 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA

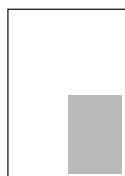


**UNI / UNI PAGE**  
 203 X 230 mm  
 + REFIL / BLEED  
 187 X 218 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA

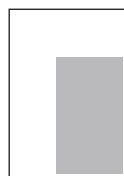


**1/2 PAGINA VERTICALE**  
 1/2 PAGE VERTICAL  
 132 X 310 mm  
 + REFIL / BLEED  
 115 X 262 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA

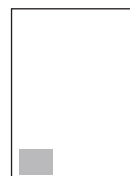
DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA  
 PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA  
 1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA



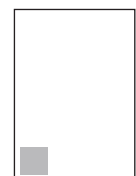
**1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE**  
 133 X 155 mm  
 + REFIL / BLEED  
 115 X 137 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA



**JUNIOR / JUNIOR**  
 154 X 201 mm  
 + REFIL / BLEED  
 140 X 183 mm  
 IN GABBIA / TYPE AREA



**MANCHETTE 1° COPERTINA**  
 79 X 61 mm  
 MANCHETTE NEWS  
 91 X 61 mm



**SPAZIO MERCATO**  
 78 X 78 mm